

PRESSEMITTEILUNG

INNO-Pouch 2026: Europas Pouch-Gipfel in Barcelona

Barcelona, Juni 2026 – Die INNO-Pouch bringt am **8. und 9. Oktober 2026** zum neunten Mal die europäische Pouch-Branche zusammen – Gastgeber ist **HP in Sant Cugat (Barcelona), Spanien**. Als einzige europäische Fachveranstaltung mit exklusivem Fokus auf Standbodenbeutel widmet sich die Fachveranstaltung in diesem Jahr den drei Säulen der modernen flexiblen Verpackung: Digitalisierung, Konformität und technische Performance - zugleich bietet sie einen exklusiven Einblick in die **HP Digital Pouch Factory**.



Unter dem Leitthema „Smart Pouches – Digital, Compliant, Tight“ diskutieren internationale Experten, wie digitale Technologien, neue Materialkonzepte und regulatorische Anforderungen die Entwicklung der nächsten Generation von Standbodenbeuteln prägen und beschleunigen. Im Fokus stehen KI-gestützte Verpackungsentwicklung sowie digitale Produktinformationen. Experten zeigen praxisnahe Wege auf, die die strengen Anforderungen der EU-Verordnungen (u. a. PPWR) rechtssicher erfüllen. Technologisch liegt der Schwerpunkt auf der Herausforderung „Tightness“ – wie Mono-Materialien trotz reduzierter Komplexität maximale Barrierewirkung und Siegelfestigkeit behalten.

Europas Pouch-Experten treffen sich in Barcelona

Der englischsprachige Kongress wird simultan in mehrere Sprachen übersetzt und schafft damit optimale Voraussetzungen für den internationalen Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices. Zu den Programmhöhepunkten zählen:

- **Christoph Waldau (Berndt+Partner)** mit Strategien für den optimalen Einsatz von Standbodenbeuteln und der Frage, wann Pouches die beste Verpackungslösung darstellen
- **Claire Gusko (one.five)** mit aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen für recyclingfähige Doypacks
- **Alexandre Zuber (Interzero)** über digitale Werkzeuge zur Umsetzung von Recyclingfähigkeit, PPWR-Anforderungen und Verpackungs-Compliance
- **Philippe Van Damme (LyondellBasell)** mit Praxisbeispielen für Mono-Material-Lösungen auf Basis von PE und PP
- **Yael Barak (HP Printing and Computing Solutions)** The 5 Great Transitions in the Flexible Packaging Industry
- **Milena Seybold (Herrmann Ultraschalltechnik)** zu Ultraschallsiegeltechnologien für Monomaterial- und Spout-Pouches.

Exklusive Einblicke in die HP Digital Pouch Factory

Ein besonderes Highlight ist die Besichtigung der **HP Digital Pouch Factory** am Standort Sant Cugat del Vallès. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in moderne Digitaldruck- und Produktionsprozesse für flexible Verpackungen und erleben innovative Pouch-Technologien direkt in der industriellen Anwendung.

Networking für die Verpackungen von morgen

Neben den Fachvorträgen bietet die INNO-Pouch vielfältige Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. Hersteller, Markenartikler, Verarbeiter, Maschinenbauer und Technologieanbieter nutzen die Veranstaltung, um Erfahrungen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Lösungen für die Herausforderungen der Verpackungswelt zu entwickeln.

„Die Zukunft flexibler Verpackungen entsteht dort, wo Materialinnovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenkommen. Mit der INNO-Pouch schaffen wir eine internationale Plattform, auf der Experten aus ganz Europa ihr Wissen teilen und gemeinsam an den Verpackungslösungen von morgen arbeiten.“

Julian Thielen, Co-Geschäftsführer der Innoform Coaching GmbH

Weitere Informationen und Anmeldung

<https://www.innoform-coaching.de/tagung/inno-pouch-smart-pouches-2026>

Event Manager:

Wilma Igelbrink:

+49 5405 80767-25

[E-Mail senden](#)